

# 2026年3月期 決算説明

株式会社フェローテック

1. 当期連結決算においては、連結子会社は2025年1月～2025年12月末の業績を連結しております。
2. 本資料は、2026年3月期本決算の業績に関する情報の提供を目的としたものであり、当社株式の購入や売却等を勧誘するものではありません。投資に関する決定は、利用者ご自身のご判断において行われるようお願いいたします。
3. 本資料は開示日現在のデータに基づいて作成されております。本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点の当社の判断であり予告なしに変更されることがあります。

The logo for FerroTec, featuring the word "FerroTec" in a white sans-serif font. The "er" in "Ferro" is stylized with a red dot above it, and the "o" is a solid red circle.

## ▶ 2025年5月30日開示の中期経営計画からローリングアップデート

### 事業成長

- 半導体関連の需要が増加するなか、日本・欧米顧客の中国外製造（Ex-China）のニーズに対応してマレーシア等の生産を拡充すると共に、中国において顧客対応を強化し、成長を実現する
- 特にAI・データセンター関連事業に注力しつつ、半導体関連、電子デバイス、自動車関連事業を拡大し、成長を追求する

### 収益性向上 生産効率向上

- マレーシア（クリム、ジョホール）工場の生産拡充・効率性向上による収益率の引き上げ実現
- グループとしてコスト管理・コスト削減のPDCAを推進
- デジタル化・自動化・AI化を展開し、生産効率向上・全面的なコスト削減・競争力強化を追求する
- 各事業の研究センターで新製品・新技術の開発を推進・強化、「品質は命」と考え品質管理徹底を継続

### 人材強化 企業文化

- 企業文化は企業の礎であり、「顧客を尊敬、従業員を尊敬し、勤勉と信用を尊重し、着実に行動し、革新を追求する」指針の浸透活動を継続する
- 人材重視を重要な経営戦略とし各事業において研修・トレーニングを実施、人材の採用・育成を推進

### 財務 株主還元

- 株主還元強化のため、DOE採用し下限を3.5%に設定、財務の状況等を考慮しながら自社株式の取得を機動的に検討し、総還元性向は50%を目指して充実を図っていく方針（不変）
- 2026年3月期～2027年12月期にかけて、グループ資産売却500億円を想定
- 2026年12月期～2028年12月期にかけて、250億円の自己株買いを実施する方針

# トピックス① 半導体関連の需要取り込みへ生産体制を拡充（マレーシア） **FerroTec**

▶ 欧米顧客の中国外生産（Ex-China）ニーズに対応し、マレーシアに大規模な量産拠点を立ち上げ

マレーシア・クリム第1工場



- 顧客認定および量産開始、生産量増加が順調に進捗
- 今後、顧客認定と生産量増加が更に進み、収益への貢献が期待できる

マレーシア・クリム第2工場



- 2026年8月に建屋工事が完了予定
- 2026年内に稼働開始見通し



## トピックス② 半導体関連の需要取り込みへ生産体制を拡充（中国）

- ▶ 中国半導体市場では、顧客拠点近隣に工場設置することにより顧客対応を強化し、国産化需要の取り込み、中国国内の高付加価値品の販売拡大を図る



### 北京工場

部品洗浄・金属加工・セラミックス



- 2026年3月に着工し、同12月の建屋完成に向けて進捗
- 2027年6月に操業開始を予定

### 紹興工場

部品洗浄

パワー半導体用基板



- 2027年夏に操業開始を予定

### 武漢工場

部品洗浄



- 最先端の洗浄ラインを設置
- 2027年夏に操業開始を予定

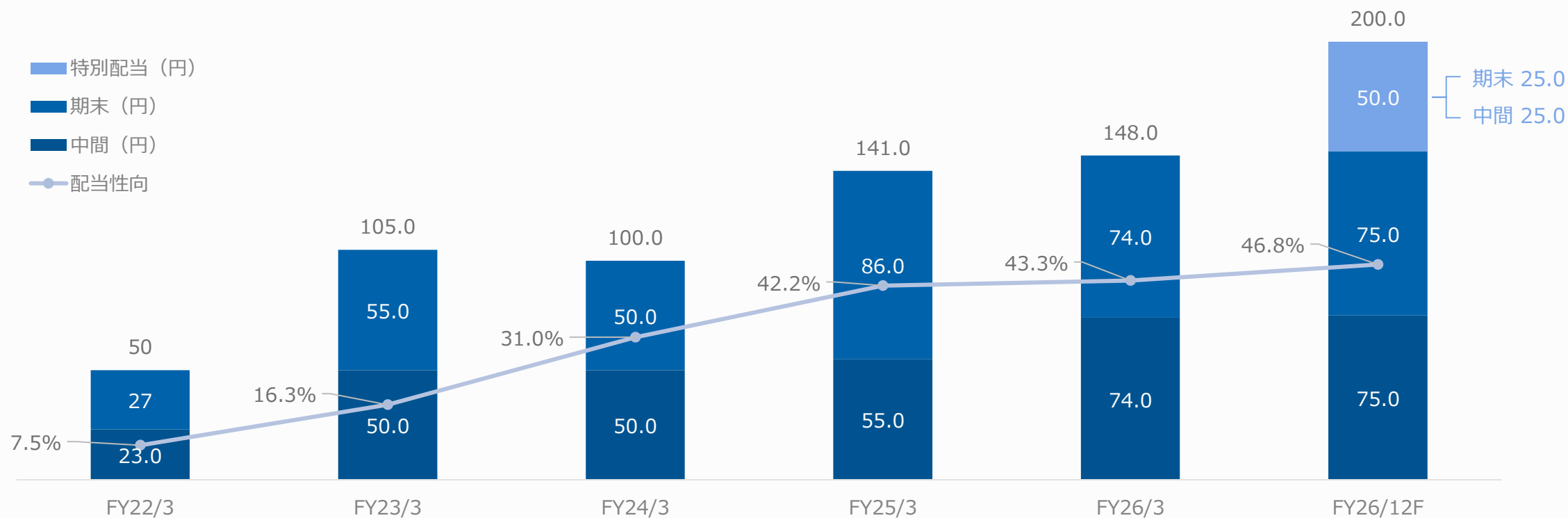
## トピックス③ 株主還元方針

▶ 株主還元強化を図るため、DOEを採用し下限を3.5%に設定、財務の状況を考慮しながら、自社株式の取得を機動的に検討し、総還元性向50%を目指して充実を図っていく（既存方針から不変）

▶ 配当金は増配、通期200円/株（普通配当150円＋特別配当50円、配当性向46.8%）を予定

※2026年12月期の中間配当は、配当基準日を9月30日から6月30日に変更し配当を実施する予定です。

1株あたり配当金の推移



1. 連結決算サマリ
2. 連結貸借対照表／キャッシュ・フロー
3. 2026年12月期 通期業績予想
4. 中期経営計画

# 1. 連結決算サマリ

---

# 通期連結決算サマリ

▶ 売上は前期比+5%、営業利益+14%

▶ 為替差損益24億円悪化、法人税等が約20億円増、当期純利益は前期比5%減

(百万円)	2026年3月期 金額	2025年3月期 金額	YoY	
			金額	増減率
売上高	288,933	274,390	14,542	105.3%
売上原価	207,616	201,029	6,586	103.3%
売上総利益	81,317	73,361	7,955	110.8%
販売管理費	53,755	49,271	4,483	109.1%
営業利益	27,561	24,089	3,471	114.4%
経常利益	26,063	25,558	505	102.0%
非支配株主に帰属する純利益	3,540	3,607	-66	98.1%
親会社株主に帰属する純利益	14,886	15,692	-806	94.9%
減価償却費	27,426	23,672	3,754	115.9%
為替レート（期中平均）	米ドル	149.78	152.24	
	中国元	20.87	21.12	



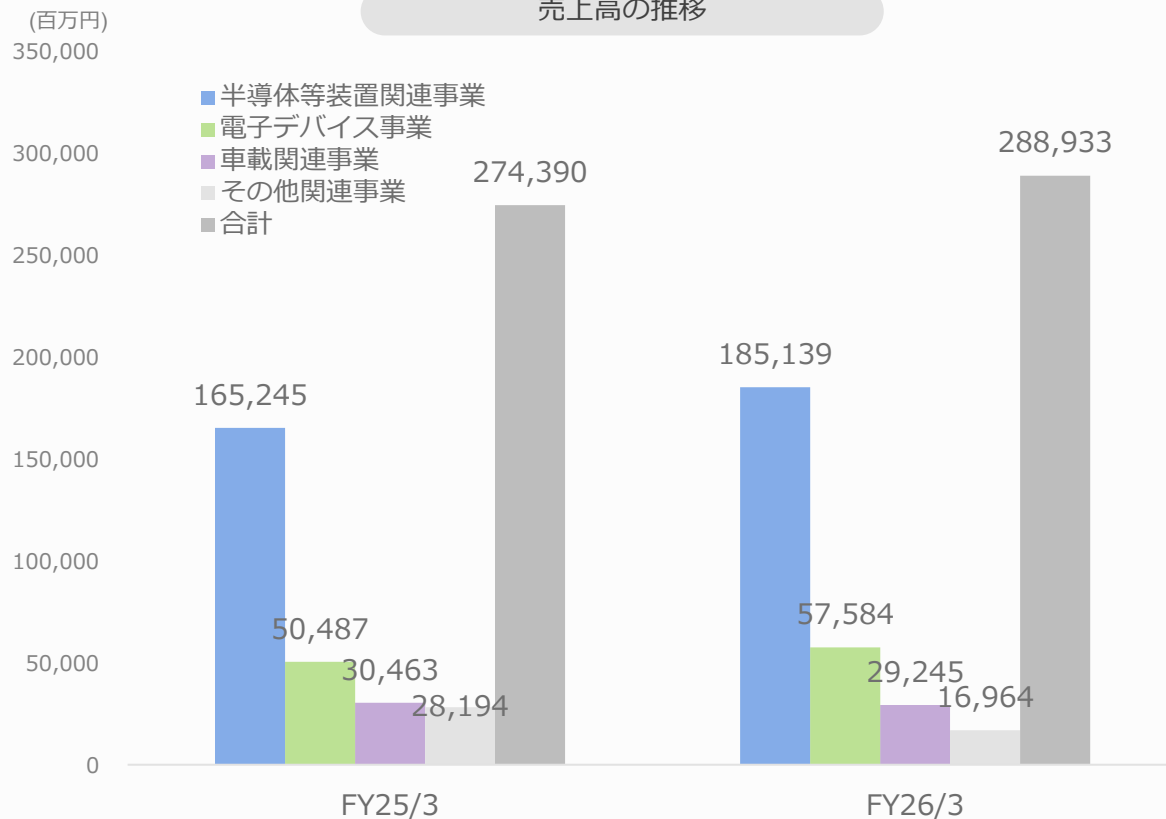
# セグメント別 売上高・営業利益サマリ

▶ 半導体等装置関連：売上は前期比+12%の1,851億円、営業利益は+30%の160億円

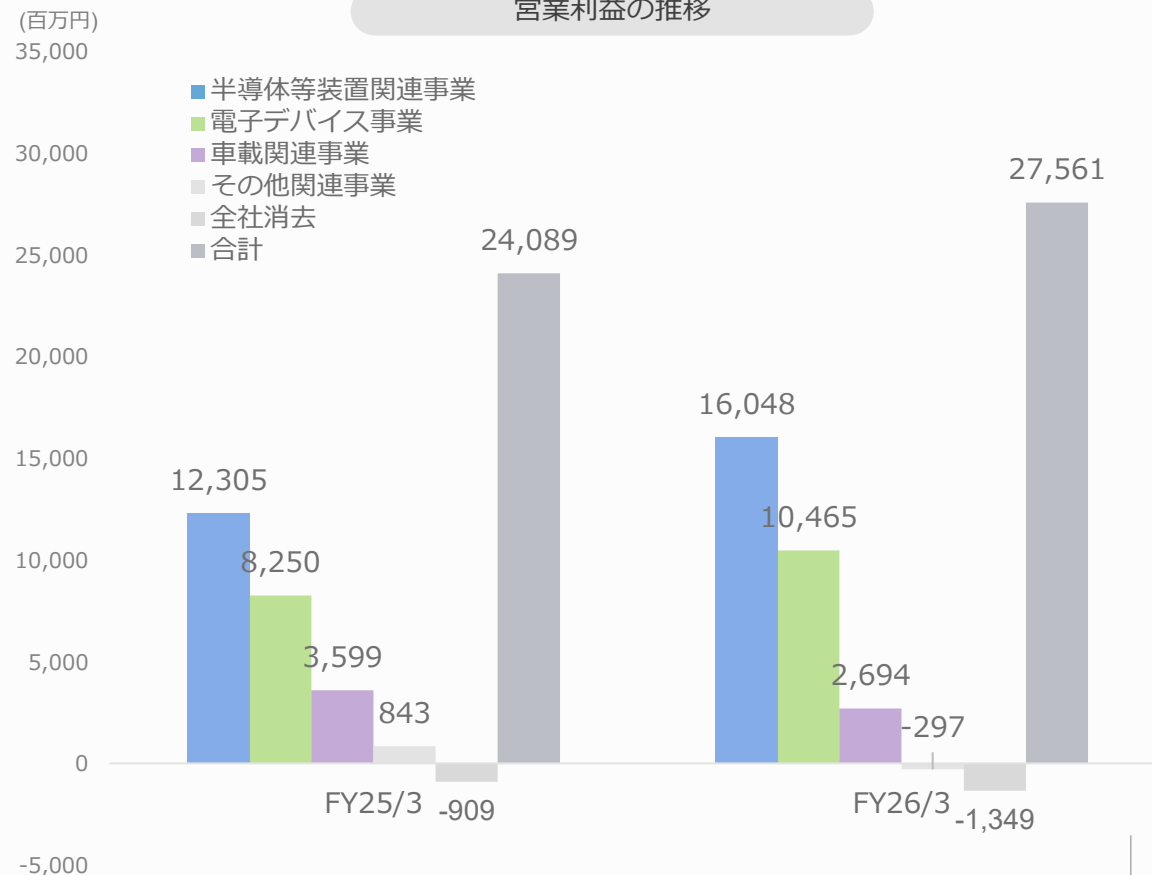
▶ 電子デバイス：売上は前期比+14%の575億円、営業利益+26%の104億円

▶ 車載関連：売上は前期比-4%の292億円、営業利益は-25%の26億円

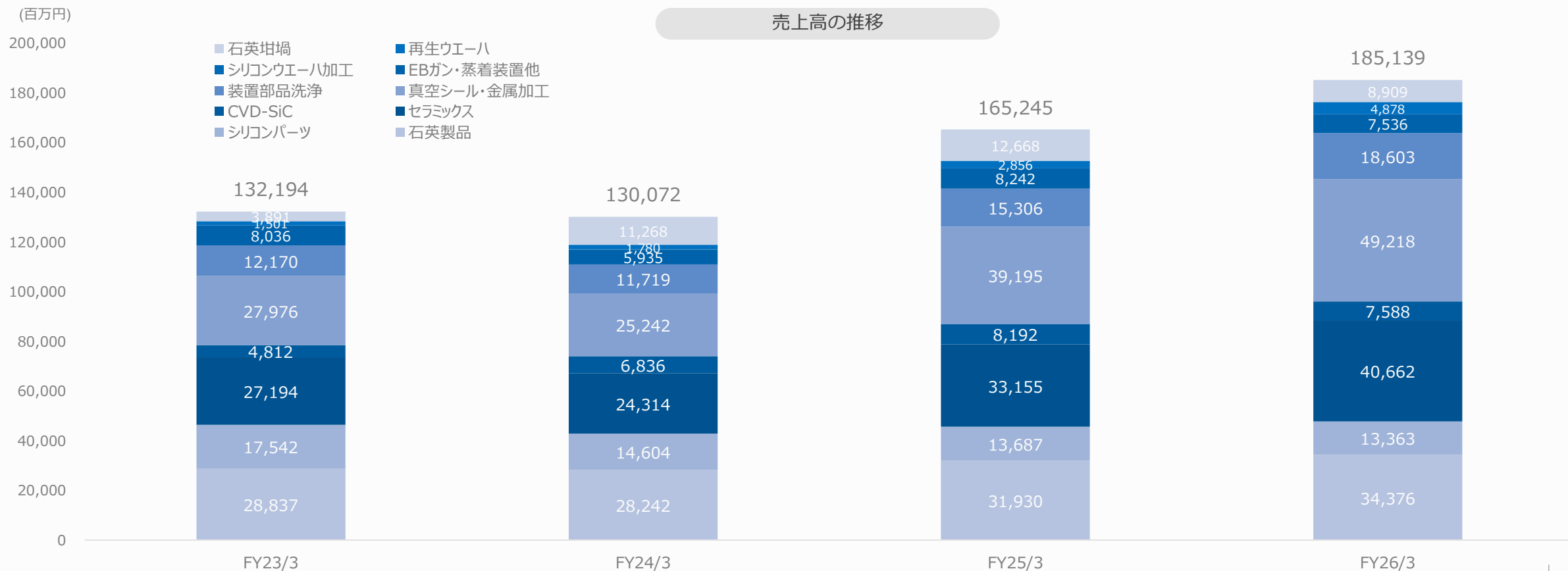
売上高の推移



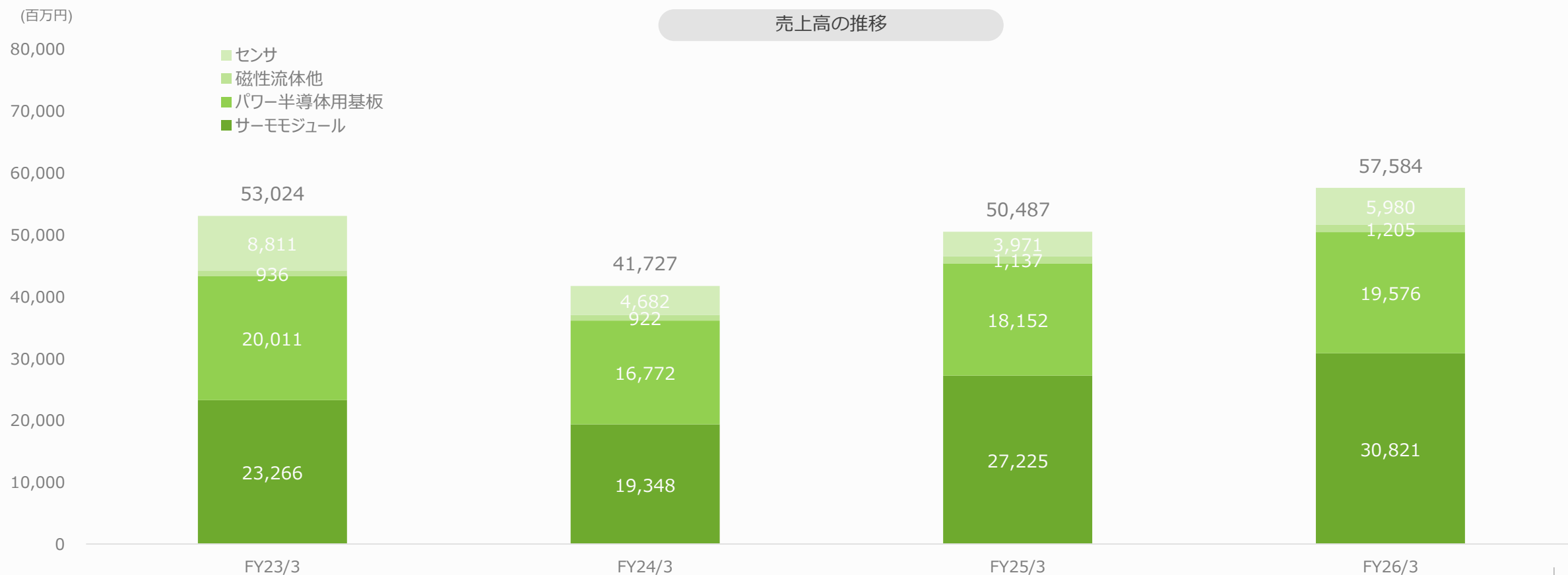
営業利益の推移



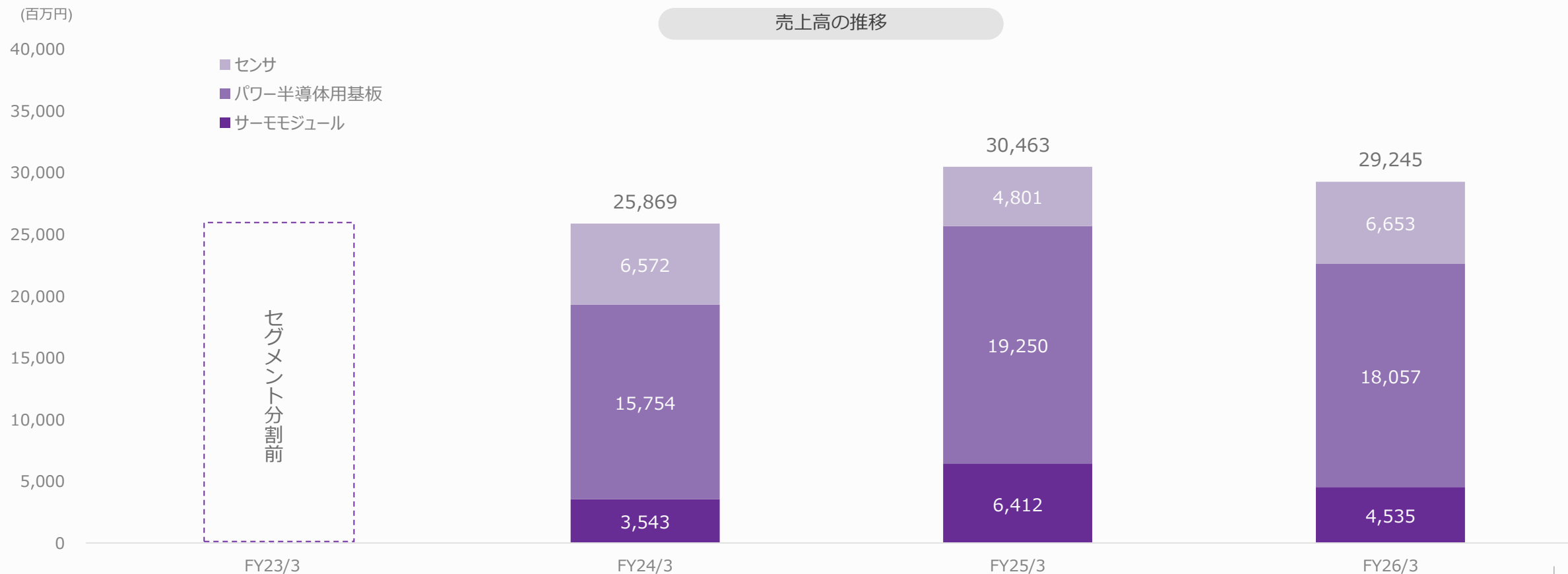
- ▶ 半導体装置メーカーの生産増強による需要増加を取り込み、特にセラミックス、真空シール・金属加工が増加
- ▶ 主に中国の半導体製造の増加に伴い、装置部品洗浄、再生ウエーハも増進



- ▶ 好調な生成AIサーバ投資を背景に光トランシーバー向けサーモモジュールの売上が拡大
- ▶ センサは大泉製作所の決算期変更により、前年度は1Qの売上計上がなく前年比で増加



- ▶ EV向け等のパワー半導体用基板の需要が調整局面となり売上・利益とも低調、サーモモジュールも苦戦
- ▶ センサは大泉製作所の決算期変更により、前年度は1Qの売上計上がなく前年比で増加



## 2. 連結貸借対照表／キャッシュ・フロー

---

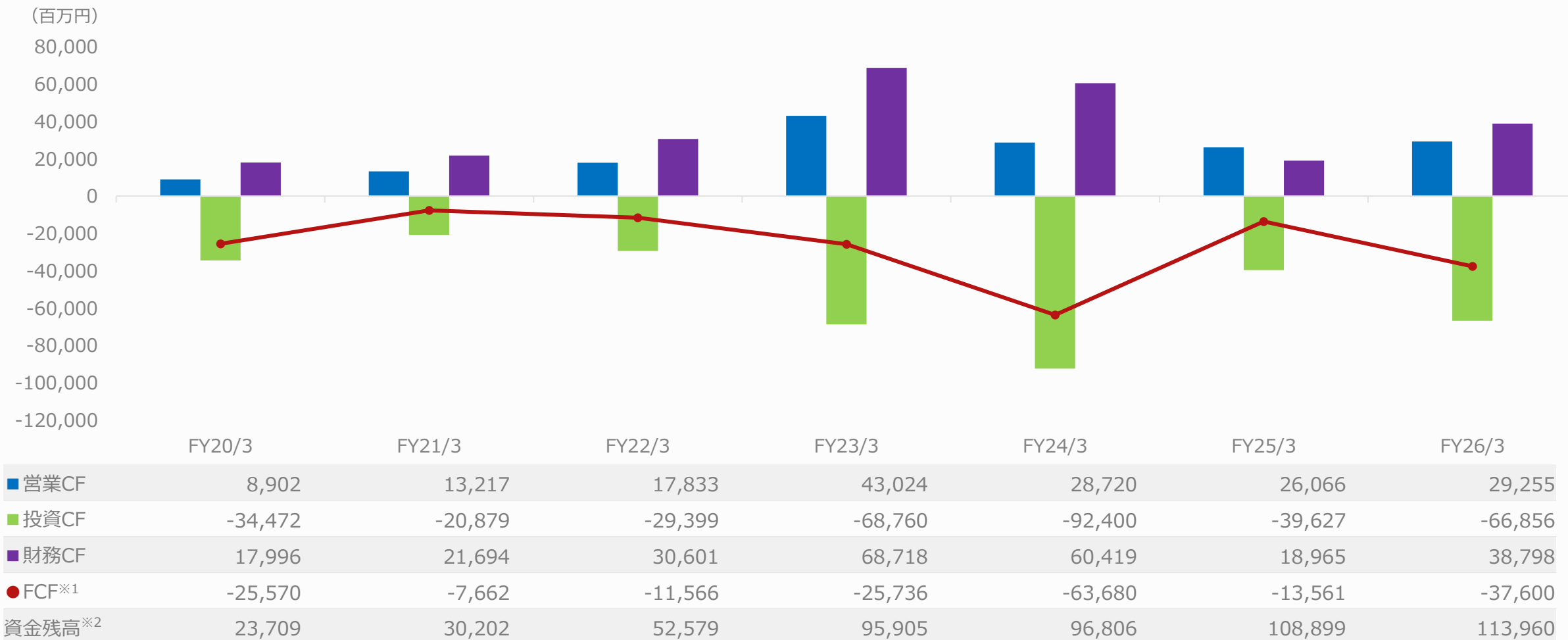


# 連結貸借対照表

## ▶ マレーシア工場への設備投資等により有形固定資産が360億円増加、有利子負債が400億円増加

(百万円)	25/3期 期末	26/3期 期末	増減額
流動資産	295,367	338,977	43,610
現金及び預金	117,727	129,918	12,191
受取手形及び売掛金	92,608	101,710	9,102
たな卸資産	72,078	88,309	16,230
固定資産	305,226	350,260	45,033
有形固定資産	245,064	281,107	36,043
資産合計	600,593	689,238	88,644
流動負債	151,750	163,052	11,301
固定負債	125,292	164,110	38,817
有利子負債合計	162,296	202,344	40,047
負債合計	277,043	327,162	50,119
純資産	323,549	362,075	38,525
負債・純資産合計	600,593	689,238	88,644
自己資本比率	39.4%	37.6%	-1.8P
為替レート（期末日）	米ドル	158.18	156.56
	中国元	21.67	22.36

▶ 営業CF増加もマレーシア設備投資等により投資CF増加が先行し、FCFは赤字



※1. 営業CF+投資CF

※2. 現金及び現金同等物の期末残高

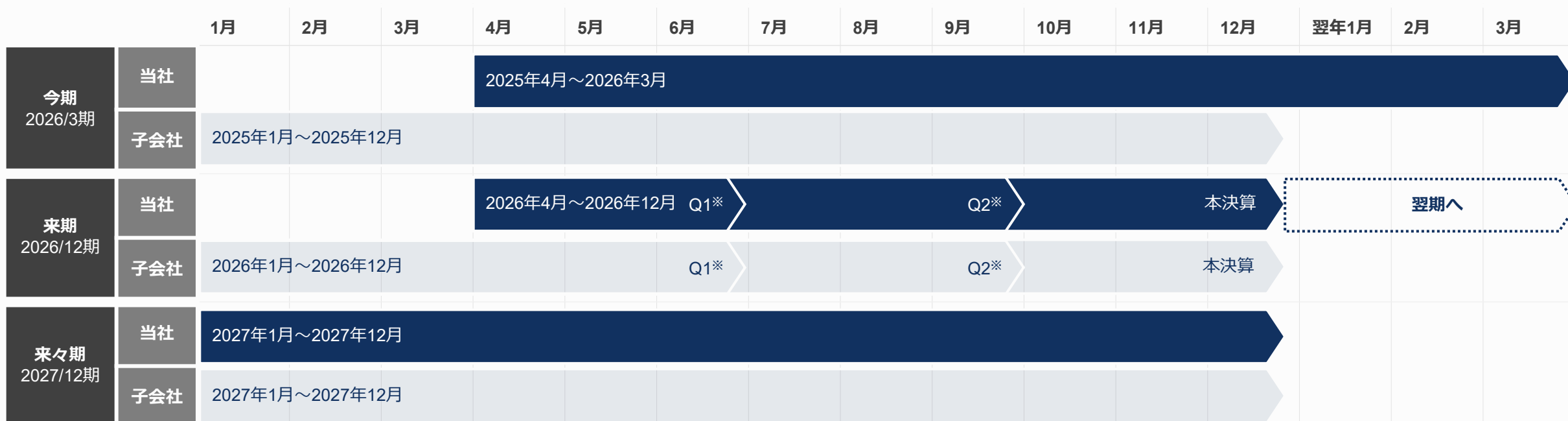
## 3. 2026年12月期 通期業績予想

---

# 決算期変更（4-3月→1-12月）

- ▶ 来期より決算期を3月から12月に変更することを、6月26日株主総会の承認を前提に5月15日取締役会で決議しました。
- ▶ 来期は「2026年4～12月」/9か月決算となりますが、当社の連結子会社は12月決算であることから、連結子会社は1月～12月/12カ月の売上損益が計上され、当社単体のみ4月～12月/9か月の売上損益が計上されます。よって、9か月決算となることの連結業績への影響は限定的です。
- ▶ 来々期は 当社および子会社とも「2027年1～12月」/12カ月決算となります。

決算期変更後のスケジュール



※来期の当社Q1決算は2026年4～6月（子会社は同1～6月）、Q2決算は同4～9月（子会社は同1～9月）の実績となる。

# 2026年12月期 通期業績予想

▶ 半導体等装置関連の需要が好調、光トランシーバー向けサーモモジュールの増加が継続で、増収増益を予想

(百万円)	2026年3月期 期末	2026年12月期 期末	
	実績	予想	前年比 (参考値)
売上高	288,933	350,000	121.1%
営業利益	27,561	38,000	137.9%
経常利益	26,063	36,000	138.1%
親会社株主に帰属する当期純利益	14,886	23,000	154.5%
設備投資額※	54,598	65,000	119.1%
減価償却費	27,426	32,172	117.3%
EBITDA	54,988	70,172	127.6%
為替レート (期中平均)	米ドル	149.78	150.0
	中国元	20.87	21.00

※有形固定資産および無形固定資産の取得額の合計





# 製品別売上高サマリ – 2026年3月期実績と2026年12月期予想

(百万円)	2026年3月期 実績	2026年12月期 予想		■ 見通し等
	通期	通期	前年比 (参考)	
半導体等装置関連	185,139	222,190	120.0%	米国および中国顧客からの引合いが急速に増加、増加見通し
真空シール・金属加工	49,218	68,307	138.8%	半導体製造装置の生産に連動性あり。金属加工、装置組立が急伸
石英製品	34,376	38,912	113.2%	半導体製造に連動する消耗材の要素あり、また、顧客在庫の影響も受ける
シリコンパーツ	13,363	17,198	128.7%	装置メーカーからの引合い増加
セラミックス	40,662	49,036	120.6%	半導体製造装置の生産に連動性あり
CVD-SiC	7,588	4,416	58.2%	決算期変更の影響（主にFTJが事業主体）および特定製品の需要減少による
EBガン・LED蒸着装置他	7,536	7,059	93.7%	需要不冴、減収予想
再生ウエーハ	4,878	2,943	60.3%	2026年7月以降は非連結化し、連結売上計上しない予定
装置部品洗浄	18,603	22,848	122.8%	中国での半導体製造工場の稼働に連動性あり
石英坩堝	8,909	11,471	128.7%	PV向け縮小、半導体向けに注力し復調
電子デバイス	57,584	73,965	128.4%	サーモモジュールが牽引し増加見通し
サーモモジュール	30,821	40,526	131.5%	AI関連の光トランシーバー向け売上拡大を見込む
パワー半導体用基板	19,576	22,511	115.0%	製品レンジ拡大により売上増大を見込む
磁性流体他	1,205	1,534	127.2%	既存製品の増加、新製品の立ち上げ
センサ	5,980	9,394	157.1%	前期は決算期変更から1-3月売上計上なし
車載関連	29,245	36,135	123.6%	EV市況は回復傾向、対26/3期で改善を見込む
サーモモジュール	4,535	5,846	128.9%	自動車向け製品の引合い増加
パワー半導体用基板	18,057	22,247	123.2%	中国EV生産の回復を見込む
センサ	6,653	8,042	120.9%	前期は決算期変更から1-3月売上計上なし。営業強化により売上増加
その他	16,964	17,710	104.4%	
合計	288,933	350,000	121.1%	

## 4. 中期経営計画

---

▶ 2026年12月期以降の予想・計画を上方修正、2028年12月期ROE・ROIC目標引下げも引続き各15%・8%を目指す

単位：百万円 (    )内は前回計画比		2026年3月期 実績	2026年12月期 予想	2027年12月期 計画	2028年12月期 計画
業績	売上高	288,933 (+3,933)	350,000 (+10,000)	400,000	450,000
	営業利益	27,561 (-2,439)	38,000 (+3,000)	48,000 (+1,000)	57,000
	営業利益率	9.5%	10.9%	12.0%	12.7%
	当期純利益	14,886 (-1,114)	23,000 (+3,000)	30,000 (+1,000)	38,000
資本効率	ROE	6.0%			11.0% (-4%)
	ROIC※1	3.2%			7.0% (-1%)
財務	自己資本比率	37.6%	40.0%	40.0%	40.0%
	設備投資額	54,598 (-10,402)	65,000 (+20,000)	55,000 (+25,000)	40,000
株主還元	1株あたり配当金※2（年間）	148.0円	200.0円	DOE（連結株主資本配当率※2）を採用、下限を3.5%に設定 自社株式取得を機動的に検討、総還元性向50%を目指す	

※1 親会社帰属純利益/(有利子負債+純資産) 但し純資産は新株予約権、非支配株主持分は除く

※2 連結株主資本=資本金+資本剰余金+利益剰余金-自己株式、連結株主資本配当率=配当金総額÷連結株主資本

## ▶ 2025年5月30日開示の中期経営計画からローリングアップデート

### 事業成長

- 半導体関連の需要が増加するなか、日本・欧米顧客の中国外製造（Ex-China）のニーズに対応してマレーシア等の生産を拡充すると共に、中国において顧客対応を強化し、成長を実現する
- 特にAI・データセンター関連事業に注力しつつ、半導体関連、電子デバイス、自動車関連事業を拡大し、成長を追求する

### 収益性向上 生産効率向上

- マレーシア（クリム、ジョホール）工場の生産拡充・効率性向上による収益率の引き上げ実現
- グループとしてコスト管理・コスト削減のPDCAを推進
- デジタル化・自動化・AI化を展開し、生産効率向上・全面的なコスト削減・競争力強化を追求する
- 各事業の研究センターで新製品・新技術の開発を推進・強化、「品質は命」と考え品質管理徹底を継続

### 人材強化 企業文化

- 企業文化は企業の礎であり、「顧客を尊敬、従業員を尊敬し、勤勉と信用を尊重し、着実に行動し、革新を追求する」指針の浸透活動を継続する
- 人材重視を重要な経営戦略とし各事業において研修・トレーニングを実施、人材の採用・育成を推進

### 財務 株主還元

- 株主還元強化のため、DOE採用し下限を3.5%に設定、財務の状況等を考慮しながら自社株式の取得を機動的に検討し、総還元性向は50%を目指して充実を図っていく方針（不変）
- 2026年3月期～2027年12月期にかけて、グループ資産売却500億円を想定
- 2026年12月期～2028年12月期にかけて、250億円の自己株買いを実施する方針

## 業績

- 2026年3月期の売上高は2,889億円、営業利益は276億円、当期純利益149億円  
新工場の在庫評価減の増加等あり利益伸び悩み
- 2026年12月通期予想は、売上高3,500億円、営業利益380億円、当期純利益230億円

## 顧客動向

- AI関連の半導体投資・生産が活発化するなか、米国半導体顧客の中国外生産（Ex-China）ニーズへの対応が進捗、顧客からの引合いおよび増産要請が強い
- 中国半導体の投資・生産の増加、顧客対応進め、金属加工・セラミックス等の引合い増勢
- サーモモジュールは、光通信モジュール向けの引合いが引続き堅調

## 設備投資

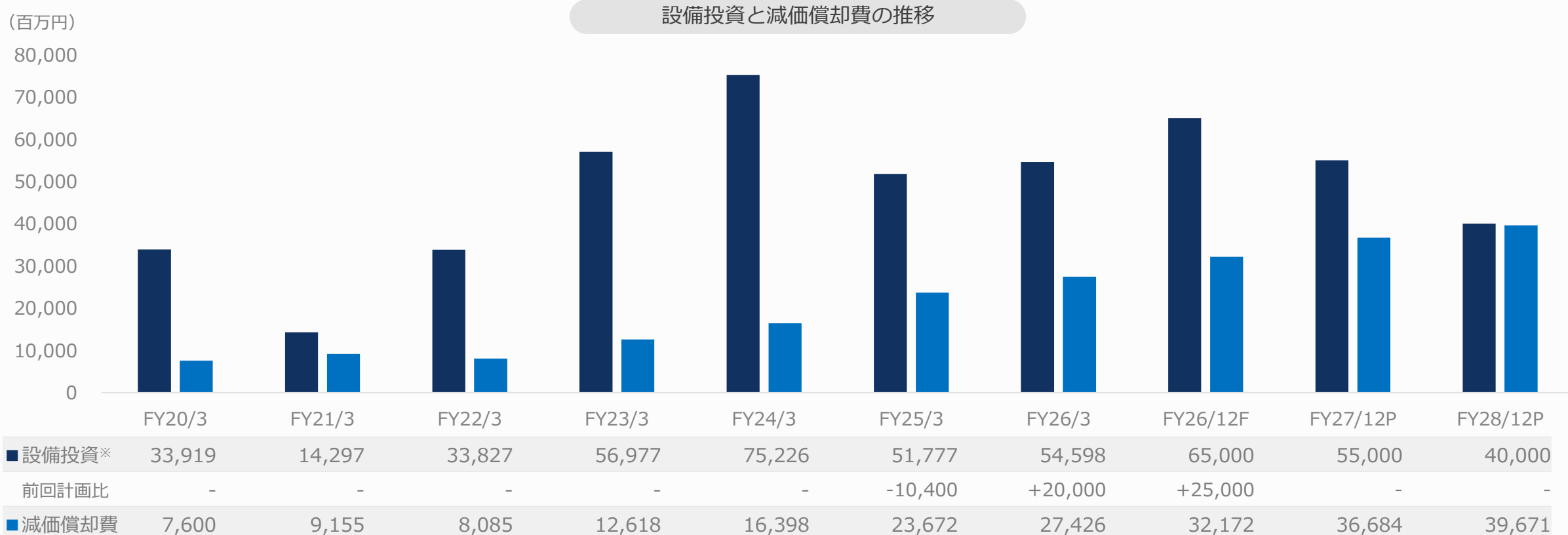
- マレーシア・クリム工場の顧客認定・立ち上げは順調、第二工場（セラミックス、石英、金属加工）は2026年中の稼働予定、需要旺盛で顧客から更なる増産要請あり検討中
- 北京工場（洗浄・金属・セラ）を新設、顧客対応を強化

## 株主還元他

- 2026年12月期～2028年12月期にかけて、250億円を上限に自己株買いを実施する方針
- 2026年12月期は増配、通期200円/株（普通配当150円、特別配当50円）を予定



- ▶ 半導体需要の増進および顧客要請を受け、北京工場（洗浄等）の新設に加え、セラミックス等の増産投資、マレーシア工場の追加投資を織り込み、2026年3月期～2027年12月期の設備投資計画は 1,746億円 に増加
- ▶ 2026年3月期～2027年12月期でのグループ資産売却500億円を想定（既存方針から不変）



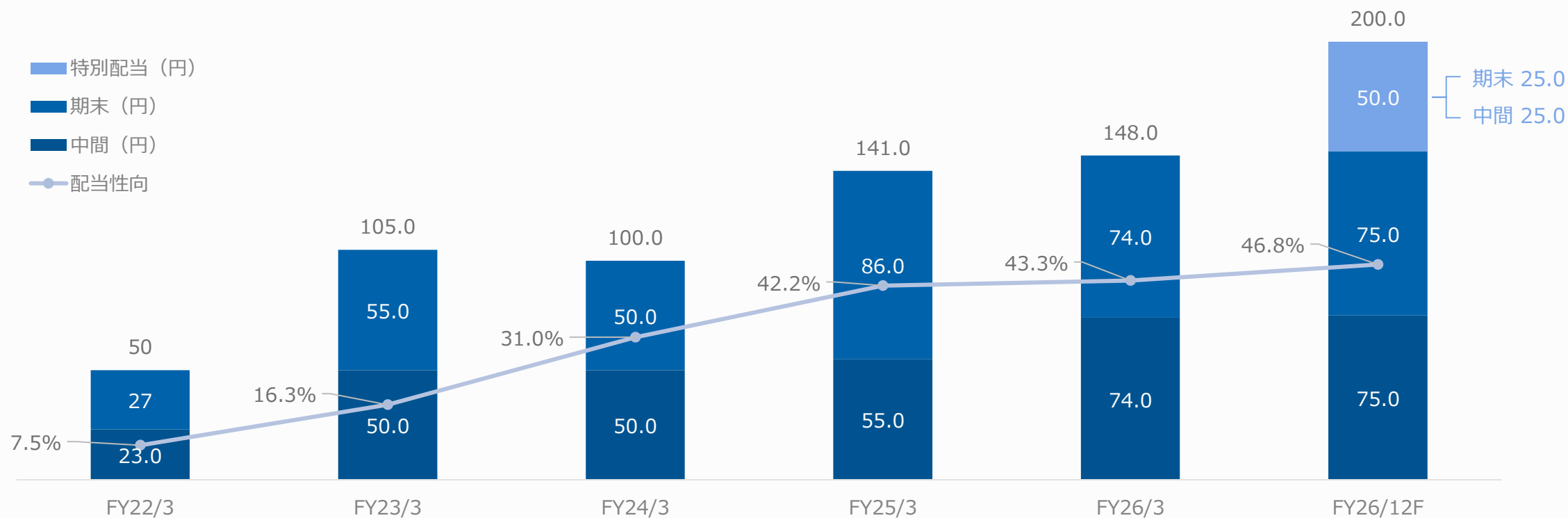
※有形固定資産および無形固定資産取得額の合計

▶ 株主還元強化を図るため、DOEを採用し下限を3.5%に設定、財務の状況を考慮しながら、自社株式の取得を機動的に検討し、総還元性向50%を目指して充実を図っていく（既存方針から不変）

▶ 配当金は増配、通期200円/株（普通配当150円＋特別配当50円、配当性向46.8%）を予定

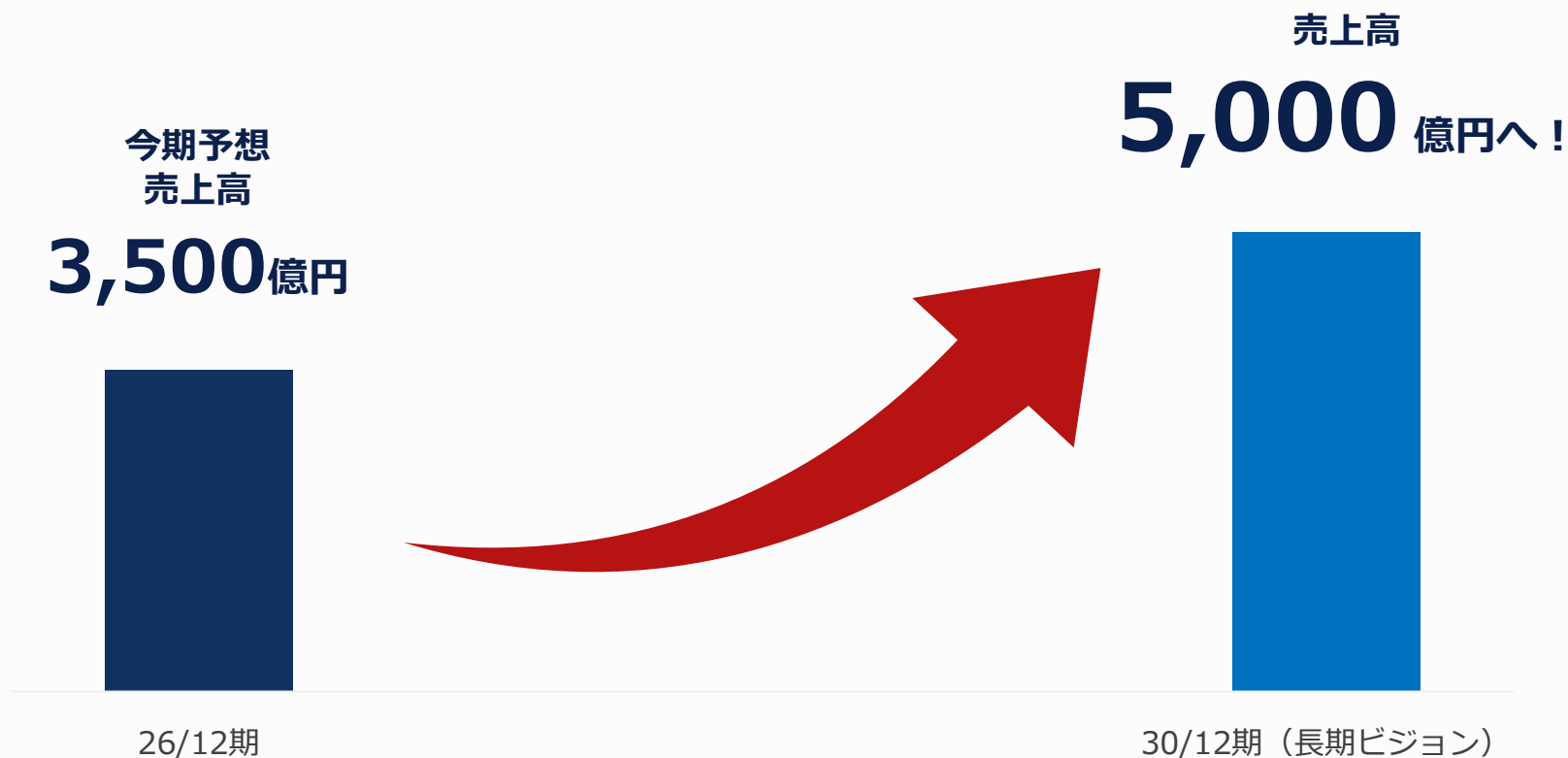
※2026年12月期の中間配当は、配当基準日を9月30日から6月30日に変更し配当を実施する予定です。

1株あたり配当金の推移



▶ 長期業績目標は継続、早期の達成を目指す

2030年度に 売上高 **5,000**億円 当期純利益 **500**億円 の達成を目指す！



# Appendix

---

# 新工場の立ち上げスケジュール

▶ 新工場の量産→本格稼働の開始により利益貢献が本格化し、利益率の改善に寄与する見通し

	所在地		2025	2026	現在	2027	2028	2029	想定生産能力
パワー半導体用基板	中国	内江	量産開始			本格稼働			230億円
パワー半導体用基板	マレーシア	ジョホール	試運転・認証取得			量産開始	本格稼働		110億円
セラミックス	日本	石川第3		試運転・認証		量産開始	本格稼働		30億円
セラミックス・Siパーツ・CVD-SiC	中国	常山3期	試運転・認証			量産開始	本格稼働		170億円
石英・セラミックス・金属加工	マレーシア	クリム第1	量産開始			本格稼働			300億円
石英・セラミックス・金属加工	マレーシア	クリム第2				試運転・認証	量産開始	本格稼働	280億円
金属加工	中国	常山4期		試		量産開始	本格稼働		60億円
装置部品洗浄	日本	熊本		試運転・認証		量産開始	本格稼働		20億円
洗浄・金属加工・セラミックス	中国	北京					試運転・認証	量産開始	70億円
装置部品洗浄	中国	紹興					試運転・認証	量産開始	170億円
装置部品洗浄	中国	武漢					試運転・認証	量産開始	20億円

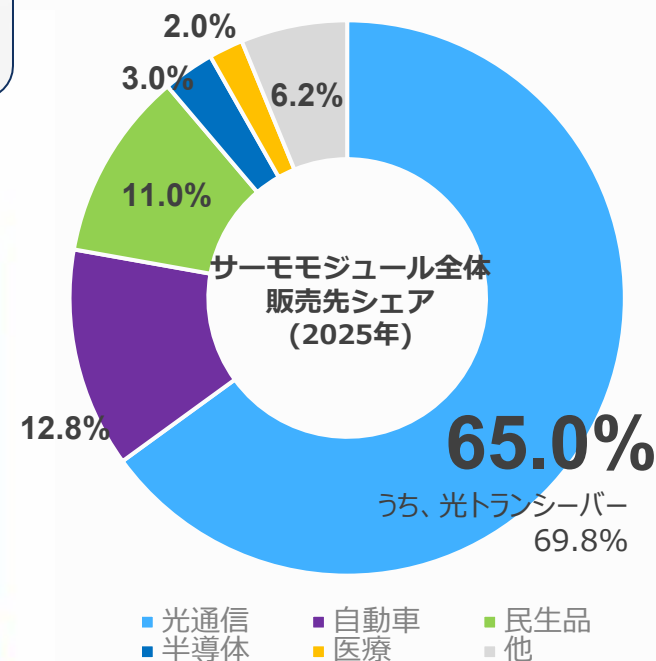
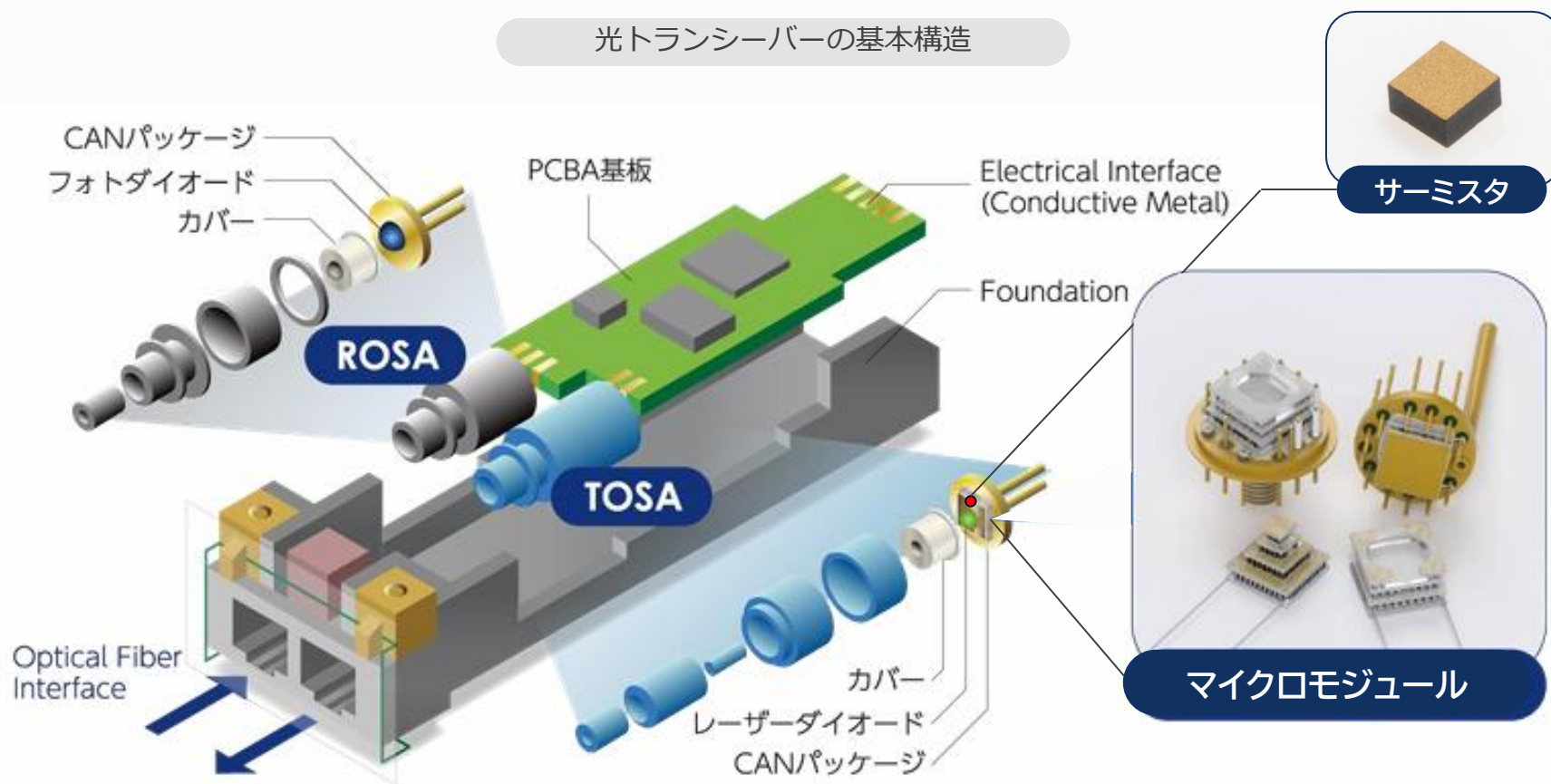
※想定生産能力は最大生産量を販売した場合の売上高



# AI向けビジネス（サーモモジュール）

- ▶ 生成AIの発展と需要拡大に伴い、データセンター投資は2030年までに100兆円規模に達すると予測されている
- ▶ 生成AIサーバーに使用される通信容量の大きいモデル（800G・1.6T）を製造する世界有数の光トランシーバーメーカーで高い顧客内シェアを有しており、サーモモジュールとサーミスタ（温度センサ）の販売量増加が期待できる

光トランシーバーの基本構造



# 中国子会社の動向（上場子会社関連）

事業	装置部品洗浄	パワー半導体用基板	シリコンウエーハ	石英坩堝・シリコンパーツ
会社名	安徽富樂德科技發展股份有限公司	江蘇富樂華半導体科技股份有限公司	杭州中欣晶圓半導体股份有限公司	寧夏盾源聚芯半導体科技股份有限公司
略称	FTSVA	FLH	CCMC	FTNC
持分・出資比率	52.4%		23.43%（持分法適用会社）	60.13%
時価・評価額※	約402億元（約9,394億円）		約234億元（約5,472億円）	約55億元（約1,294億円）
持分相当額	4,922億円		1,282億円	778億円
新株発行予定比率	—		10%以上	10%以上
上場市場	深圳証券取引所 創業板		新三板（全国中小企業株式譲渡システム）	—
証券コード	301297		874810	—
上場ステータス 今後の見通し等	2022年12月30日上場	2025年7月FTSVA子会社化	2025年9月22日登録	2025年1月上場申請取下げ （再申請検討中）

※2026年5月15日時点（1中国元＝23.33円）

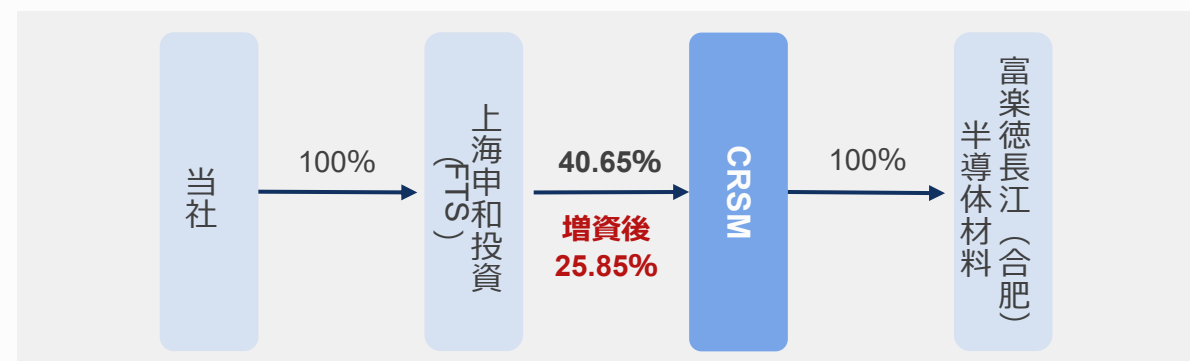
# 再生ウエーハ事業（CRSM）の持分法適用会社への異動

- ▶ 再生ウエーハ事業を行う安徽富楽徳長江半導体材料（CRSM）が、中国・合肥地区での新会社および新工場設立に伴い増資を実施することにより、連結子会社から持分法適用会社へ異動となる（2026年7月以降見込み）
- ▶ 再生ウエーハ事業への成長投資であるとともに、当社の事業の選択と集中を通じた収益性の改善を目指すものである

## 新会社および新工場投資の概要

会社名	富楽徳長江（合肥）半導体材料股份有限公司
投資金額	20億元（約466億円）※1中国元 = 23.31円 ・新工場（合肥工場）：16億元（約373億円） ・銅陵工場増強：4億元（約93億円） ↳ 14億元を出資、6億元を融資で賄う予定
新工場建屋総床面積	約80,000m <sup>2</sup>
スケジュール	・着工開始：2026年5月 ・建屋完成：2027年3月 ・設備据付：2027年9月 ・操業開始：2027年12月予定

## 当社との資本関係



## CRSM（再生ウエーハ）の業績

（百万円）	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期
売上高	1,501	1,774	2,869
営業利益	-1,251	-1,329	-1,483
経常利益	-864	-816	-1,267
親会社株主に帰属する当期純利益	-260	-282	-515

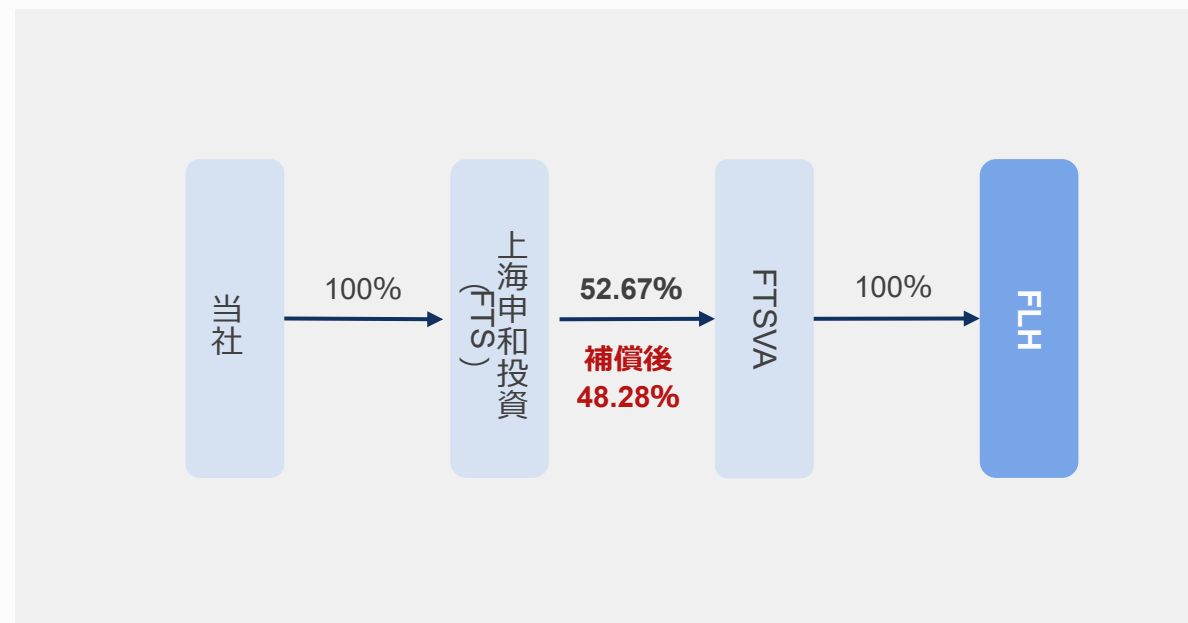
# FLH（パワー半導体用基板）の利益補償について

- ▶ FLHの実績が承諾純利益額を下回ったため、FTSVAがFTSの保有するFTSVA株式を買い戻し・消却する※1
- ▶ 本件株式買戻し・消却自体は、連結子会社間の株式移動であり支配関係は継続する為、連結損益に影響はない

## 利益補償の概要

(百万元)	2025年度※2
純利益（実績）	124.2
承諾純利益	285.2 (26年度：342.1、27年度：414.2、3か年合計：1,041.5)
補償すべき金額	1,028
FTS出資比率の減少幅	-4.39P

## 当社との資本関係



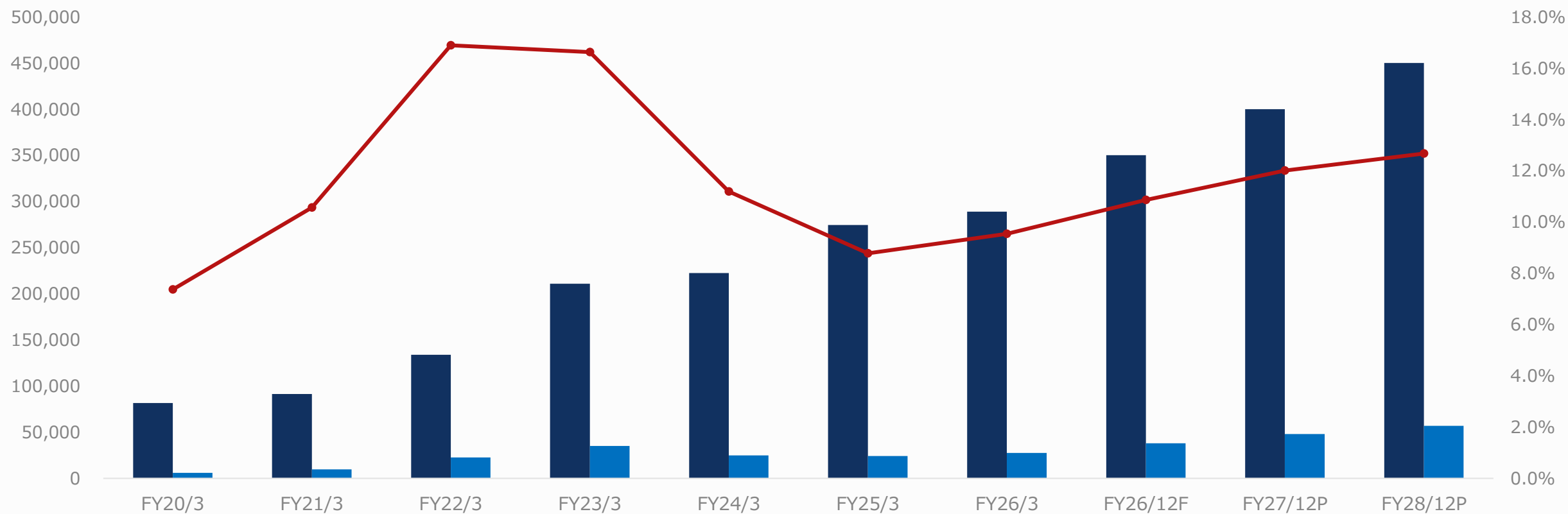
※1. 20260430開示『（開示事項の経過）当社中国子会社（FTSVA）における利益補償契約に基づく自己株式の取得及び消却に関するお知らせ』ご参照

※2. 会計年度は1月～12月

# Q4連結決算サマリ

(百万円)	2026年3月期 Q4 金額	2026年3月期 Q3 金額	QoQ		2025年3月期 Q4 金額	YoY	
			金額	増減率		金額	増減率
売上高	77,287	70,665	6,622	109.4%	72,025	5,262	107.3%
売上原価	57,874	49,541	8,332	116.8%	55,146	2,727	104.9%
売上総利益	19,413	21,123	-1,709	91.9%	16,878	2,534	115.0%
販売管理費	13,691	13,616	74	100.6%	12,485	1,206	109.7%
営業利益	5,721	7,506	-1,784	76.2%	4,393	1,328	130.2%
経常利益	6,426	6,713	-286	95.7%	5,041	1,385	127.5%
非支配株主に帰属する純利益	871	773	97	112.6%	591	280	147.4%
親会社株主に帰属する純利益	4,740	3,837	903	123.5%	3,080	1,660	153.9%
減価償却費	7,490	6,685	805	112.0%	6,376	1,114	117.5%
為替レート（期中平均）	米ドル	149.78			152.24		
	中国元	20.87			21.12		

(百万円)



売上高	81,613	91,312	133,821	210,810	222,430	274,390	288,933	350,000	400,000	450,000
営業利益	6,012	9,640	22,600	35,042	24,872	24,089	27,561	38,000	48,000	57,000
営業利益率	7.4%	10.6%	16.9%	16.6%	11.2%	8.8%	9.5%	10.9%	12.0%	12.7%

# セグメント別 売上高

(百万円)

300,000

- その他関連事業 / Other-related
- 車載関連事業 / Automotive-related
- 電子デバイス事業 / Electronic Device
- 半導体等装置関連事業 / Semiconductor Equipment-related

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0

FY20/3

FY21/3

FY22/3

FY23/3

FY24/3

FY25/3

FY26/3

81,613

15,830

13,489

53,201

91,312

13,778

17,273

60,718

133,821

16,517

27,023

90,280

210,810

25,590

53,024

132,194

222,430

24,757

25,872

41,727

130,072

274,390

28,194

30,463

50,487

165,245

288,933

16,964

29,245

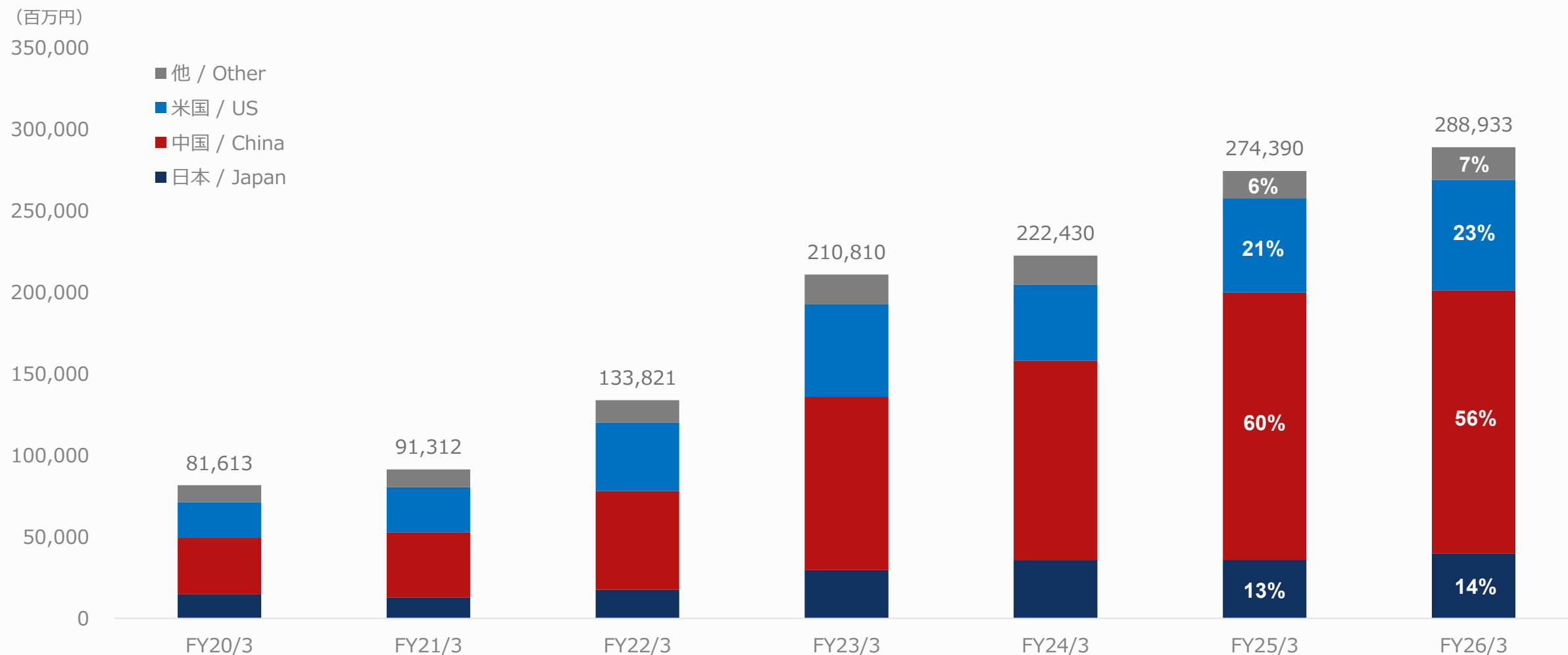
57,584

185,139

セグメント分割

## 地域別 売上高構成比

▶ 地域区分は売上計上エンティティの所在地に基づく





# 会社概要

商号	株式会社フェローテック	
英文表記	Ferrotec Corporation	
設立	1980年9月27日	
代表者	代表者取締役社長 グループCEO 賀 賢漢	
本社	東京都中央区2-3-4 日本橋プラザビル5F	
上場市場	東証スタンダード（証券コード 6890）	
連結売上高	2,889億3,300万円	
資本金	295億4,942万円	
従業員数	連結：16,858名	単体：519名
関連会社	連結子会社：80社	持分法適用子会社：13社

（2026年3月期）

## 事業セグメント

### 1. 半導体等装置関連事業

ー真空シール、石英、セラミックス、シリコンパーツ、CVD-SiC、シリコンウエーハ、部品洗浄、金属加工・組立等

### 2. 電子デバイス事業

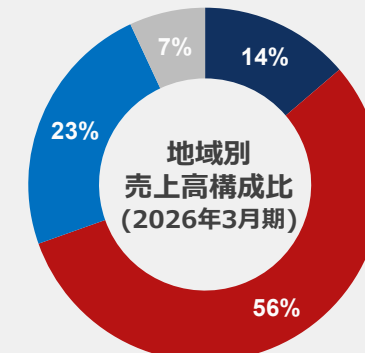
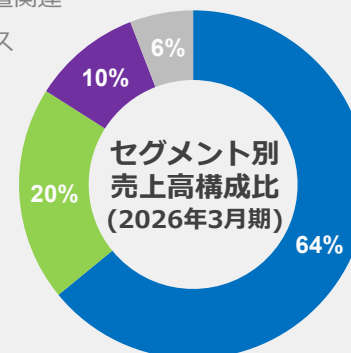
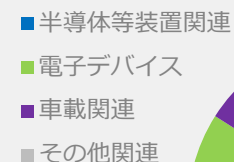
ーサーモモジュール、パワー半導体用基板、センサ、磁性流体

### 3. 車載関連事業

ーサーモモジュール、パワー半導体用基板、センサ

### 4. その他関連事業

ー機械刃物、産業用クリーニング機器、インゴット引上げ装置等



## 半導体等装置関連セグメント



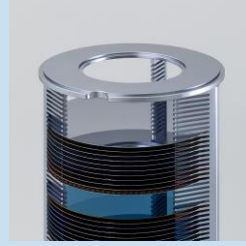
真空シール



金属受託加工



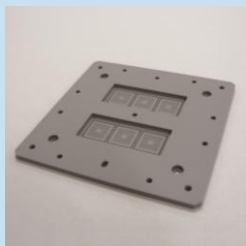
石英製品



シリコンパーツ



ファインセラミックス



マシナブルセラミックス



CVD-SiC



装置部品洗浄



EBガン



石英るつぼ

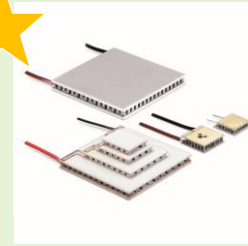


再生ウエーハ



シリコンウエーハ

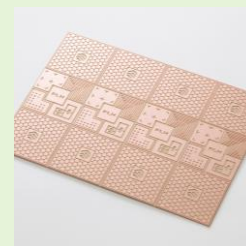
## 電子デバイスセグメント



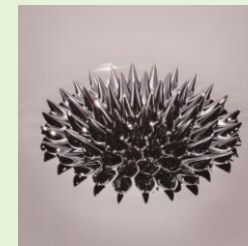
サーモモジュール



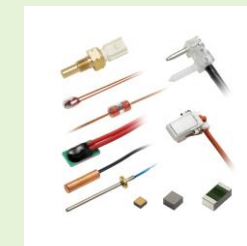
チラー



パワー半導体用基板

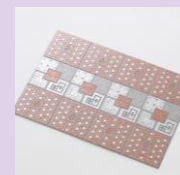


磁性流体



センサ

## 車載関連セグメント

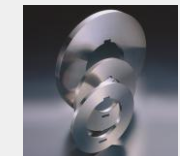


パワー半導体用基板



センサ

## その他関連セグメント



工業用刃物、他

# フェローテックグループ 拠点一覧

モスクワ  
ニジニ・ノヴゴロド  
フランクフルト  
シュツットガルト

グルグラム

銀川  
天津  
青島  
大連  
義王  
石川  
東京  
内江  
東台  
上海  
杭州  
麗水  
熊本  
広州  
新竹  
クリム  
クアラルンプール  
ジョホール・バル  
シンガポール

リバモア  
サンノゼ

ベットフォード

## 欧州

- フランクフルト（ドイツ）  
EBガン
- シュツットガルト（ドイツ）
- モスクワ（ロシア）  
サーモモジュール
- ニジニ・ノヴゴロド（ロシア）  
サーモモジュール

## 米国

- ベットフォード  
真空シール、磁性流体
- リバモア  
精密蒸着装置
- サンノゼ  
真空装置、真空部品

## 中国

- 杭州  
サーモモジュール、真空シール、石英、セラミックス、Siパーツ、金属加工、工業用刃物、半導体用ウエーハ
- 上海  
パワー半導体用基板、半導体用ウエーハ、部品洗浄
- 銀川  
石英坩堝、半導体用インゴット、Siパーツ
- 銅陵  
部品洗浄、再生ウエーハ、SiCウエーハ
- 東台  
パワー半導体用基板、石英
- 常山  
石英、サーモモジュール、金属加工
- 麗水  
センサ、半導体用ウエーハ
- 嘉興  
サーモモジュール
- 天津  
部品洗浄
- 大連  
部品洗浄
- 広州  
部品洗浄
- 青島  
部品洗浄

## 日本

- 東京【本社】
- 千葉  
真空シール、磁性流体
- 石川  
セラミックス
- 岡山  
CVD-SiC
- 山形  
石英
- 熊本  
部品洗浄
- 仙台
- 関西
- 熊本

## その他（アジア）

- クリム（マレーシア）  
金属加工・組立、石英、セラミックス
- ジョホール・バル（マレーシア）  
Siパーツ
- クアラルンプール（マレーシア）
- シンガポール
- 新竹（台湾）
- 義王（韓国）
- グルグラム（インド）



工場



営業所



研究所

- ▶ IRポータルサイト「IR STREET」にIRニュースを掲載・メール配信しております  
以下のQRコードもしくはリンクより、配信先メールアドレスをご登録いただけます

日本語



[登録ページリンクはこちら](#)

English



[Go to Registration Page](#)

- ▶ 本資料に掲載されている将来見通しの記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報および将来の業績に影響を与える不確実な要因の仮定を前提としております。
- ▶ 実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる可能性があります。業績に影響を与える要素には、国際情勢、経済情勢、製品の需給動向、原材料価額および市況、為替レートなどが含まれますが、これに限定されるものではありません。
- ▶ 本資料の数値は、百万円単位もしくは億円単位に端数処理をして記載しております。したがって、決算短信や有価証券報告書等の開示書類の数値と完全に一致しない場合がございます。
- ▶ 本資料中の定量目標などは、あくまで中長期的な戦略、ビジョン等を示すものであり業績予想ではありません。当社はこれらについて情報を更新する義務を負いません。
- ▶ 正式な業績予想は、東京証券取引所規則に基づく決算短信での開示をご参照ください。